

芯原微电子（上海）股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯原”）致力于提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，切实履行上市公司的责任和义务，进一步提升公司经营效率，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。现将进展情况公告如下：

一、聚焦主营业务，提升科技创新能力

（一）技术研发

自公司制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司持续推进核心技术的研发迭代，以保持技术先进性和核心竞争力，并始终关注市场趋势和技术发展动向，针对目标和关键市场，积极开展新技术的研发，进一步提升公司的科技创新能力和核心竞争力。

公司在持续优化迭代现有核心技术的基础上，于报告期内进一步就生成式人工智能（AIGC）、数据中心、智驾系统、智慧可穿戴设备、物联网这几个关键应用领域，以及 Chiplet 技术进行深入的技术研发和产业化推进。

1) 云侧 AIGC 和数据中心应用领域

芯原已成为全球领先云服务提供商的可信合作伙伴。根据灼识咨询的最新报告，芯原已为 2025 年全球 10 大云服务提供商中的 7 家提供了芯片定制解决方案服务和半导体 IP 授权服务。

公司基于 20 余年 Vivante GPU 的研发经验，所推出的具有自主知识产权的

通用图形处理（GPGPU）IP 可以支持大规模通用计算和 AIGC 相关应用，现已被客户采用部署至各类高性能 AI 芯片中，面向数据中心、高性能计算等应用领域。通过将自有的 GPU 和 NPU 技术进行流水线级的深度融合，该 IP 可灵活支持图形渲染、通用计算以及 AI 处理，为数据中心、云游戏、边缘服务器、AIGC 相关应用提供大算力通用处理平台，并利用统一的软件接口和一体化的编译器，让用户可以使用标准编程接口来驱动不同的硬件处理单元。目前，芯原的 GPGPU IP 在全球范围内已进行了多次架构授权，在众多高性能计算产品中获得应用。

芯原的视频转码加速解决方案已获得中国前 5 名互联网企业中的 3 家，以及全球前 20 名云服务提供商中的 7 家的采用。这其中，第一代视频转码平台已于 2021 年第二季度完成研发，并以 IP 授权、芯片定制等方式获得多家客户的采用并量产出货。第二代平台芯片定制项目已完成交付，平台在上一代基础上实现了技术全面升级：支持包括 AV1 在内的多格式 8K 视频转码，集成 AI 处理能力，搭载高性能多核 RISC-V CPU 与硬件加密引擎，现已成功导入国际领先芯片客户并实现量产。第三代平台已进入研发阶段，该平台定位为高性能异构计算平台，以高性能、低功耗、多场景适配为设计核心，深度融合 AI 加速、视频处理与实时控制能力，并集成 CPU、DSP、VPU、NPU、硬件加密模块及安全启动等多核心子系统，全面支撑 AI 推理、视频转码与边缘计算等复杂业务场景，同时还通过精细化电源管理及多电源域控制设计，显著优化系统能效表现。

芯原还正在进行基于 Chiplet 架构、面向 AIGC 应用的高性能计算芯片项目的研发。

2) 端侧 AIGC 应用领域

芯原全球领先的 NPU IP 已在 91 家客户的 140 余款芯片中获得采用，覆盖服务器、汽车、平板电脑、智能手机、智能家居、可穿戴设备等 10 余个市场领域。目前集成了芯原 NPU IP 的 AI 类芯片已出货约 2.5 亿颗。芯原最新一代 NPU 架构针对 Transformer 类模型进行了优化，既能高效运行 Qwen、LLAMA 类的大语言模型，也能支撑 Stable Diffusion、MiniCPM 等 AIGC 和多模态模型。目前，芯原超低能耗 NPU 已可为移动端大语言模型推理提供超 40 TOPS 算力，并已在知名企业的手机和平板电脑中量产出货。芯原的 NPU 还与自有的众多处理器 IP

深度集成，形成包括 AI-ISP、AI-Display、AI-DSP 在内的众多 AI 加速子系统解决方案。基于其可编程、可扩展特性，以及自有的创新 NeuroBrick 片上硬件加速解决方案，芯原的 NPU IP 还可针对不同应用场景极大优化客户芯片的 PPA 特性。目前，芯原的 AI-ISP 芯片定制方案（芯原提供架构设计、软硬协同设计和量产支持）已在知名企业的智能手机中量产出货。

公司基于第五代经硅验证的 DSP 架构的 ZSP5000 系列 IP，采用高可扩展性和低功耗的设计，针对计算机视觉、嵌入式人工智能等计算密集型应用进行了深度优化，结合架构的可配置能力，可为各类边缘设备提供兼具能效优势和计算效率的优秀解决方案。

针对 AIGC 产业所面临的安全性和隐私性等问题，芯原还与谷歌合作以支持其新推出的开源项目 Open Se Cura。该项目是一个由设计工具和 IP 库组成的开源框架，旨在加速安全、可扩展、透明和高效的人工智能系统的发展。作为该项目基础设施的一部分，芯原开发了多款面向特定应用的平台级解决方案，支持超低能耗空间计算，并提供优质、高效的 AIGC 输入（Token）。此外，芯原与谷歌基于该 Open Se Cura 开源项目合作基础，还共同打造了面向端侧大语言模型应用、基于 RISC-V 指令集的超低能耗 Coral NPU IP，这其中，谷歌提供开源技术，芯原提供企业级 IP、芯片设计及量产服务，为 AI 眼镜和 AI 戒指等可穿戴设备，以及 AI 玩具等提供“始终在线、超低能耗、超轻量”的端侧 AI 解决方案。

以智能可穿戴应用领域为例，芯原从数年前就开始与该领域领先的企业合作，利用自身低功耗技术方面的优势，积极布局蓝牙耳机、智能手表/手环和 AI/AR 眼镜，并已在芯片和终端产品中验证了芯原面向低能耗应用所打造的 nano 和 pico 系列低功耗 IP 组合。报告期内，公司推出了超低能耗 AI/AR 眼镜 SoC 平台，该平台采用灵活可配置的定制架构，支持多种摄像头、输出接口及可选连接方案；针对严苛的可穿戴限制，采用双芯片分布式架构（主处理器与显示处理器解耦）及 HB-PoP 封装；硬件核心包括 22 个独立电源域、无 DDR 运行、支持语音/视频唤醒的多级待机系统，极致降低功耗与发热；外围提供专用 Micro LED 驱动 ASIC 和视频处理 ASIC 等。公司还基于谷歌 Gemma3-270M 轻量模型进行了端侧 AI 优化，可全面支撑始终在线、超低能耗和超轻量应用的芯片定制与量产。

目前，芯原已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务，还有数家全球领先的 AI/AR/VR 眼镜客户正在与芯原进行合作。截至报告期末，已有 20 余家核心智能手表和 MCU 芯片客户采用了芯原的 IP，市面在售的 30 余款主流智能手表和 10 余款 AI 眼镜均采用了芯原的技术。

此外，芯原以自有的低功耗 IP 为核心基础，结合自身的软件和系统平台设计能力，还推出了一系列从芯片设计到参考应用的一体化可穿戴式健康监测平台级解决方案，可为客户提供含 BLE 协议栈、软件 SDK、算法、智能硬件和应用程序等在内的不同层级的授权和定制设计服务，助力可穿戴设备在大健康领域的广泛应用。

3) 汽车电子领域

公司已耕耘汽车电子领域多年，从座舱到自动驾驶技术均有布局。芯原的 GPU IP 已经在汽车上获得了广泛的应用，包括信息娱乐系统、仪表盘、车身环视、驾驶员状态监控系统、ADAS、自动驾驶汽车等。芯原的 VPU IP 已被 2025 年中国前八大新能源汽车厂商中的五家采用。

芯原的 ISP IP 自 2017 年正式推出以来，研发与车规认证工作同步进行，目前已有多款 ISP IP 通过车规认证，获得汽车客户的广泛采用。截至报告期末，芯原的 ISP/畸变矫正（DeWarp）处理器 IP 已被国内外 20 多家汽车电子客户所采用，已有 20 余款商用汽车集成了芯原的 ISP IP，赋能百万个汽车 ADAS 摄像头。

芯原正在加速各类车规 IP 的认证进程。目前，公司多个型号的 ISP IP，畸变矫正处理 IP，显示处理 IP DC8200-FS，NPU IP VIP9000Nano 和接口 IP MIPI C/D-PHY TX/RX IP 均获得了 ISO 26262 ASIL B 认证。公司其他 IP 也正在逐一通过各类车规认证的进程中。

公司的设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务。此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，并基于该流程推出了 ADAS 功能安全方案，完整的自动驾驶软件平台框架，以及车规级高性能自动驾驶 SoC 设计平台。这其中，自动驾驶 SoC 平台衍生自

公司高性能 SoC 平台，配备高性能片上网络、CPU/NPU IP 及 ASIL D 级功能安全岛，支持客户产品获得 ISO 26262 车规认证。该平台已应用于 5nm 客户项目并实现量产。下一代平台将采用更先进工艺，通过 PCIe 和 UCIe 接口增强连接性与带宽。

目前，公司正在积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发。基于上述技术布局，芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作。

4) 物联网领域与 FD-SOI 技术

芯原持续优化和丰富自有的物联网无线连接技术平台，尤其是拓展其在 22nm FD-SOI 工艺上的射频类 IP 产品及平台方案布局，包括支持双模蓝牙、低功耗蓝牙 BLE、NB-IoT、多通道 GNSS 及 802.11ah 等物联网连接技术。所有射频 IP 均已获得客户芯片采用，且采用芯原 802.11ah、802.15.4g 和 GNSS 射频 IP 的客户芯片已量产。上述产品被广泛应用于智能家居、智能穿戴、高精度定位等领域。

FD-SOI 技术以其低功耗、高性能、高集成度的优势，在物联网领域获得了广泛应用。公司已深入布局 FD-SOI 技术十余年。截至报告期末，公司在 22/28nm FD-SOI 工艺上开发了 60 多个模拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等。已累计向 47 个客户授权了 330 多个/次 FD-SOI IP 核；并已经为国内外知名客户提供了 49 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 40 个项目已经流片。报告期内，公司还基于 FD-SOI 的低功耗技术优势，持续开发针对如 Wi-Fi 6、BLE 6、卫星通信、毫米波雷达和助听器等应用的技术平台。

5) Chiplet 技术

Chiplet 技术及产业化是芯原的发展战略之一，公司已于五年前开始布局 Chiplet 技术的研发。目前，公司正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的发展和产业化，持续提升公司半导体 IP 授权和芯片定制解决方案服务的产业价值，拓展市

场空间。

截至报告期末，公司已在基于 Chiplet 的生成式人工智能大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑，目前正在推进基于 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发项目。目前公司在 Chiplet 领域取得的切实成果包括：已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片，采用了 SiP（System in Package）先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；已帮助客户的 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWos 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCle 物理层接口，并已顺利完成流片测试，相关技术已被客户采纳用于项目开发；已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片。此外，为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯原已针对新一代面板级封装（Panel level package）技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术，芯原将与之携手，共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。

（二）人才培养

坚持引进和培养优秀人才是公司生存和发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础。

结合长期技术发展战略和现有人才储备情况，在外部人才引进方面，公司不仅通过内部推荐、网络招聘等多种渠道吸纳有经验的优秀人才，也通过每年线上及线下校园招聘会、“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛、“芯原杯”电路设计大赛、与各大重点高校联合开展技术和就业指导讲座及企业开放日，搭建“海南大学-芯原智慧医养创新实验室”“海南大学-芯原医疗电子创新实验室”“浙江大学-芯原智能图形处理器联合研究中心”“芯原股份-天津大学智能音频信息处理技术联合研究中心”，以及成立东南大学信息科学与工程学院、南京大学电子科学与工程学院、海南大学计算机科学与技术学院、海南大学生物医学工程学院、海南大学信息与通信工程学院、海南大学电子科学与技术学院的校外实习实训或教学基地等多种形式，吸引并招募国内外顶尖高校的毕业生，为公司持续稳定发展夯实人才储备。

在内部人才培养方面，公司持续构建并运行完善高效的培训体系与公开透明的晋升机制，通过线上线下相结合的技术与管理培训、专业技术及技术管理双通道发展等方式，全面提升员工的综合能力；积极营造良好的工作环境，从企业文化、薪酬福利、人才激励等方面增强员工的凝聚力与归属感。

截至 2026 年 6 月末，公司研发人员合计 1,883 人，研发人员的占比为 87.79%，研发人员中硕士及以上学历人员占比达 87.41%。公司中国大陆地区具有十年以上工龄的员工占比为 29.88%，员工平均年龄为 34 岁。依托上述行业及公司特征，公司的研发能力始终保持较高水平，已建成理论知识扎实、研发实力突出、实践经验丰富的研发团队，持续巩固业务竞争优势，构筑高水平竞争壁垒。

公司拥有丰富且优质的人才和技术储备，持续通过校园招聘招收优秀应届毕业生，优化人才梯队结构，为公司长远发展提供坚实保障。

2025 届校园招聘中，共 8,000 人参加了全球统一在线笔试，约 1,300 人进入面试环节，公司最终录用应届毕业生 100 余名，其中硕士毕业于 985、211 院校占比 97%，本硕均毕业于 985、211 院校占比 89%。2026 届校园招聘中，公司共录用 100 余名应届毕业生，硕士毕业于 985、211 院校占比提升至 100%，本硕均毕业于 985、211 院校占比提升至 94%。截至 2026 年 6 月 30 日，近四年入职的应届生累计申请专利 183 项。得益于公司优异的招聘质量和高效的培养体系，近年录用的应届毕业生已完成内部培训，为今年已启动和即将承接的多个芯片重大项目提供了有力的人才支撑。未来随着行业逐步复苏，公司项目数量增加，这批研发人员将在各自岗位上发挥关键作用。

公司高度重视人才发展与雇主品牌建设，已连续五年获评“芯片行业最佳雇主”，体现了公司在行业竞争中的软实力。截至 2026 年 6 月 30 日，公司在前程无忧雇主评选中蝉联“典范雇主”奖项并获评“员工关爱典范”单项大奖，并已连续两年荣获“人力资源管理杰出奖”之“杰出雇主”及“最佳培训实践”双料殊荣，同时连续两年获得“年度大学生喜爱雇主”奖项。此外，公司两次荣获猎聘“上海年度非凡雇主”、牛客“NFuture 大学生最喜爱雇主”和芯雇主“年度雇主”奖项。

得益于公司优秀的企业文化，公司保持较高的人才稳定性。报告期内，芯原中国大陆地区员工主动离职率为 1.8%，显著低于 2026 年中国大陆高科技行业整

体平均主动离职率 4.4%（怡安翰威特人力资本调研数据）。

（三）资源整合

报告期内，公司积极开拓 RISC-V 市场，基于芯原的半导体 IP 和芯片定制平台的技术赋能能力，持续提升芯原在相关领域中的地位与价值，并积极推动 RISC-V 产业生态的发展。

芯原已与赛昉科技、嘉楠科技、先楫半导体等多家 RISC-V 领先企业达成合作。截至报告期末，芯原的半导体 IP 已经获得 RISC-V 主要芯片供应商的 14 款芯片所采用；此外，芯原已为 26 家客户的 27 款 RISC-V 芯片提供了芯片定制解决方案服务，上述项目正陆续进入量产。同时，公司还基于 RISC-V 核推出了包含数据中心视频转码、可穿戴健康监测、物联网无线通信、带硬件安全支持的智能传感 SoC 等多个芯片设计平台，以及基于 RISC-V 核的硬件开发板，上述解决方案已获得多个客户的采用，有助于推动 RISC-V 技术的商业化进程。

2018 年 9 月，由上海集成电路行业协会推荐芯原股份作为首任理事长单位牵头成立了中国 RISC-V 产业联盟（CRVIC），截至 2026 年 6 月底，会员单位已达到 205 家。2024 年，芯原联合芯来科技、达摩院共同发起成立了民办非企业单位——上海开放处理器产业创新中心（SOPIC），该中心专注于推动处理器技术，特别是基于开放指令集架构（如 RISC-V）的研发、生态建设和产业化应用。由中国 RISC-V 产业联盟和芯原共同主办的滴水湖中国 RISC-V 产业论坛已经成功召开了四届，每届会议集中发布 10 余款来自不同本土企业的国产 RISC-V 芯片新品，现已累计推广了 40 多款，量产率达 90%，广泛应用于消费电子、智能家居、可穿戴设备、通信、汽车、工业控制等多个领域。芯原还连续 4 年举办了基于 RISC-V 技术的“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛。大赛每年吸引来自 40 多所国内高校、累计 650 多支队伍参赛，为 RISC-V 产业发展起到了很好的人才引导和培养作用。

由上海开放处理器产业创新中心于 2025 年 7 月在上海主办的第五届“RISC-V 中国峰会”规模盛大，包括 1 场主论坛、9 场垂直领域分论坛、5 场研习会、11 项同期活动，以及 4,500 平方米未来科技展览区，汇聚来自 17 个国家的数百家企业、研究机构及开源技术社区参会。主论坛当日共计 3,000 余人线下参会，12.5

万人次线上观看论坛直播；当日媒体原创报道达 200 余篇，会后媒体原创报道总数达 425 篇；参会总人次为 8188 人。该中心还联合清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、西安交通大学、同济大学、山东大学、华东师范大学、电子科技大学、上海大学和上海科技大学这 12 所高校，历时半年精心编撰和发布了《RISC-V 导论：设计与实践》研究生选修课开源课件，助力 RISC-V 专业人才培养。

二、优化运营效率，营业收入大幅增长，新签订单保持强劲增长态势，在手订单连续 11 个季度保持高位

公司 2026 上半年实现营业收入 18.64 亿元，同比增长 91.37%。2026 年第二季度实现营业收入 10.28 亿元，较 2025 年第二季度同比增长 75.95%。

截至 2026 年 6 月末，公司在手订单金额达到 124.49 亿元，较一季度末的 51.33 亿元大幅提升 142.52%，且已连续 11 个季度保持高位。截至 2026 年 6 月末的在手订单中，量产服务业务订单超 100 亿元，量产服务的规模效应显著，订单的持续转化将为公司未来盈利能力逐步提升奠定坚实基础。截至 2026 年 6 月末的在手订单中，超过 83% 为数据处理应用领域订单且主要来自于 AI ASIC。

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 16 日，公司新签订单合计 146.53 亿元，其中绝大部分为芯片定制解决方案服务业务订单，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日披露的《关于新签订单的自愿性披露公告》（公告编号：2026-040）。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 17 日，公司新签订单进一步增长至 151.42 亿元，AI 算力相关订单占比 90%，数据处理领域订单占比 89%。上述订单具备明确转化预期，但收入转化需要一定时间周期。其中，设计服务订单通常需 9-12 个月设计研发周期，期间逐步实现收入转化；量产服务业务订单受客户产品出货规划、合作晶圆厂产能排期等因素影响，从签约开始通常需 6-18 个月完整生产交付周期，期间逐步实现收入转化。

公司自 2025 年起新签订单爆发式增长，2025 年全年新签订单 59.60 亿元，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 17 日的新签订单金额已达到 2025 年全年的 254%。依托于业界领先的技术能力与客户认可度，公司新签订单将继续保持良

好态势。

自公司制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司持续优化研发、存货、应收账款、资金等事项的运营管理，以增加运营效率。

三、深入推进国际化战略，积极筹划 H 股发行上市，加强募集资金管理，按计划推进募投项目投入

为满足公司业务发展的需要，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才，深入推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司资本实力，公司拟发行境外上市股份 H 股股票并在香港联交所上市（以下简称“H 股发行上市”）。通过 H 股发行上市，公司将进一步拓宽融资渠道、提升综合融资能力，为公司统筹推进国内产业并购整合、海外优质资产并购及稳步落地全球化战略布局提供坚实的资本平台支撑。

报告期内，公司于 2026 年 3 月 10 日、2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第九次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了 H 股发行上市全套配套议案。2026 年 4 月 1 日，公司正式向香港联交所递交 H 股发行上市申请，并在香港联交所网站刊登 H 股发行上市的申请资料。

本次 H 股发行上市是公司构建 A+H 双资本平台的重要举措，有利于拓宽国际化融资渠道，增强长期资本实力。通过 H 股发行上市，公司将进一步完善公司治理结构，借鉴境外资本市场成熟的监管经验与治理理念，提升公司规范化运营水平与信息披露质量，增强公司在资本市场的核心竞争力与投资价值，实现公司股东利益最大化，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。公司将依据法律法规相关规定，根据 H 股发行上市的后继进展情况及时履行信息披露义务。

2026 年上半年，公司结合 A 股再融资及 H 股发行上市募集资金项目规划及市场情况，持续推进募投项目的研发投入。公司严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。公

司、保荐机构、存管银行持续对公司募集资金使用进行检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

四、推进内控体系建设，梳理完善现有制度以适配 H 股发行上市规范

自公司制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司不断健全公司治理结构，对内控体系进行完善，提升公司治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

2026 年 3 月，根据 H 股发行上市相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》及相关内控制度进行修订以适配 H 股发行上市规范，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于制定和修订于 H 股发行上市后适用的<公司章程>及相关内部治理制度的公告》（公告编号：2026-012）。

五、强化投资者沟通交流，切实保障投资者合法权益

自公司制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司依据《市值管理制度》等内控制度及相关法律法规的要求，以提升公司发展质量为本，始终践行“以投资者为本”的核心理念，持续提高信息披露质量与透明度，积极采取有效措施稳定并提振投资者信心，推动公司投资价值与内在发展质量相匹配。

公司于 2026 年 4 月 9 日上证路演中心平台召开了 2025 年年度业绩说明会，并将于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年半年度业绩说明会。截至本报告披露日，公司 2026 年内已举办了 10 场投资者关系活动，完成 9 个“上证 e 互动”平台问题回复，并积极通过图文简报等可视化形式对年度报告等定期报告进行解读，提高可读性，以加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。

此外，公司于 2026 年 3 月 31 日发布了《2025 年可持续发展报告》，向社会公众及投资人全面展示公司积极履行 ESG 管治的责任和义务，在社会责任、员

工关怀等方面的表现，有助于市场更充分的了解公司经营和发展情况。

六、完善投资者回报机制

自公司制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司始终立足长远战略发展目标，充分兼顾全体股东诉求，结合自身经营规划、所处发展阶段、盈利水平、现金流状况、资金需求、资金成本及外部融资环境等多重因素，并遵照《公司章程》相关规定，搭建持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，就利润分配作出制度化安排，保障利润分配政策具备合理性、连续性及稳定性。公司将严格依据经营情况执行分红政策，在条件允许时积极实施股东利润分配与现金分红，持续夯实投资者回报体系。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束并强化“关键少数”的责任

公司推崇全员持股理念，重视员工的归属感，鼓励员工和公司共发展。公司于 2026 年 8 月推出 2026 年限制性股票激励计划，通过限制性股票激励计划的实施，以长效激励驱动公司战略发展，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司长远发展，维护股东权益。

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。自公司制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司持续督促“关键少数”积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，及时传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化“关键少数”合规意识，推动公司持续规范运作。

根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内控制度，公司合理确定了董事、高级管理人员的薪酬结构和水平，董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。报告期内，董事会薪酬与考核委员会结合公司经营情况、战略发展等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进

行绩效业绩考核，确保高级管理人员的薪酬体系符合相关法律法规、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的要求，薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，激励高级管理人员积极为公司创造价值，以强化管理层与股东的利益共担共享。

八、其他措施

综上所述，报告期内，公司严格执行此前制定的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，并取得了一定进展。公司将持续对 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的具体措施进行评估，并及时履行信息披露义务。未来，公司将进一步提升经营管理水平，继续深耕主营业务，强化核心竞争力，巩固市场地位，优化盈利结构；公司管理层也将一如既往地致力于提升公司业绩和市场价值，为股东创造更多的投资回报。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日